导电点胶
Form in Place (FIP) Elastomer

产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION

导电点胶主要有导电填料和树脂等组成，这些树脂在固化后形成了导电胶的分子骨架结构，提供了力学性能和粘接性能保障，并使导电填料粒子形成通道，导电点胶可分为室温固化和高温固化体系，可采用点胶机连续作业。

Form in Place (FIP) Elastomers is mainly composed of conductive filler and resin. After curing, these resins form the molecular skeleton structure of conductive adhesive, provide the guarantee of mechanical properties and bonding properties, and form channels for conductive filler particles. Form in Place (FIP) Elastomers can be divided into room temperature curing and high temperature curing systems, which can be operated continuously by dispensing machine.



产品特点
PRODUCT FEATURE

- 就地成型，减少工艺成本
- 多种导电材质可供选择
- 低应力，高压缩
- Form in Place, Reduce process cost
- Varies of conductive materials are available
- Low stress, high compression

典型应用
TYPICAL APPLICATION

- 光模块 / Optical module
- 汽车电子 / Automotive electronics
- 服务器 / Server
- 医疗 / Medical industry
- 数据通信 / DataCom

产品参数
PRODUCT PARAMETER

产品型号 Product Name	点胶尺寸 Glue Size	填料体系 Filler Type	密度 Density	硬度 Hardness	固化条件 Curing Conditions	体积电阻率 Volume Resistivity	储存条件 Storage Conditions	颜色 Color	阻燃等级 Flammability Rating	屏蔽效果 Shelding Effectiveness	挥发性 Volatility	保质期 Shelf Life
	mm	/	g/cm³	Shore A	/	Ω·cm	℃	/	UL 94	dB@200MHz-10GHz	1000h@100℃	month
EFIP 451R	0.4 ~ 2	Ni/C	2.5	45	25℃ 24h	0.05	-10℃以下	灰黑	V-0	>100	/	6
EFIP 451H	0.8 ~ 3	Ni/C	2.1	45	150℃ 30min	0.01	-10℃以下	灰黑	V-0	>100	无挥发冷凝物	6
EFIP 303R	0.4 ~ 2	Ag/Ni	3.8	40	25℃ 24h	0.01	-10℃以下	灰色	V-0	>110	/	6
EFIP 533R	0.4 ~ 2	Ag/Ni	3.9	50	15℃~40℃, 50% Rh 24h	0.01	-30~-10℃	灰色	V-0	>110	/	6
EFIP 503R	0.4 ~ 2	Ag/Ni	3.9	50	15℃~40℃, 50% Rh 24h	0.01	-30~-10℃	黄色	V-0	>110	/	6
EFIP 563H	0.4 ~ 3	Ag/Ni	3.7	55	100℃ 2h	0.01	-10℃以下	灰色	V-0	>110	无挥发冷凝物	6